

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 05089523 A

(43) Date of publication of application: 09.04.93

(51) Int. CI G11B 7/24 G11B 11/10

(21) Application number: 04016757

(22) Date of filing: 31.01.92

(30) Priority: 31.07.91 JP 03216144

(71) Applicant: KYOCERA CORP

(72) Inventor: KYODA TAKESHI

SHIBATA TOSHIYUKI ARIMUNE HISAO

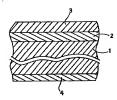
(54) OPTICAL DISK

(57) Abstract:

PURPOSE: To prevent the generation of the warpage of an optical disk by substantially equaling the products of the internal stresses of 1st and 2nd resin protective layers respectively formed on both surfaces of a plastic substrate and the thickness of the layer.

CONSTITUTION: At least an optical recording layer is formed on one surface of the plastis substate and the resin protective layer is formed thereon. The 2nd resin protective layer is formed on the other surface. The internal stresses (force per unit sectional area) generated in the 1st and 2nd resin protective layers are respectively designated as σ_1 and σ_2 and are so set that the conditions of $\sigma_1 \times \sigma_1^{-}\sigma_2 \times \sigma_2$ substantially hold. The internal stresses generated in the respective resin protective layers on both surfaces of the plastic substrate are substantially equaled in this way and, therefore, the generation of the warpage of the optical disk is prevented.

COPYRIGHT: (C)1993,JPO&Japio



(19) 日本国特許庁(IP)

(12) 公開特許公報 (A) (11) 特許出願公開番号

特開平5-89523

(43) 公開日 平成5年(1993) 4月9日

(51) Int. C1.5

庁内整理番号 鐵別記号

FΙ

技術表示箇所

G 1 1 B 7/24 11/10

7215 - 5 D 536 A 9075 - 5 D

審査請求 未請求 請求項の数2

(全5頁)

(21)出顯番号

特爾平4-16757

(22)出簡日

平成4年(1992)1月31日

(31)優先権主張番号 特顯平3-216144

(32) 優先日

平3 (1991) 7月31日

(33)優先権主張国 日本 (JP)

(71)出願人 000006633 京セラ株式会社

京都府京都市山科区東野北井ノ上町5番地

(72) 発明者 京田 豪

滋賀県八日市市蛇溝町長谷野1166番地の6 京セラ株式会社滋賀八日市工場内

(72)発明者 柴田 俊幸

滋賀県八日市市蛇溝町長谷野1166番地の6 京セラ株式会社滋賀八日市工場内

(72) 発明者 有宗 久雄

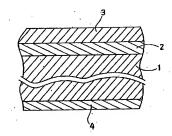
滋賀県八日市市蛇溝町長谷野1166番地の6 京セラ株式会社滋賀八日市工場内

(54) 【発明の名称】光デイスク

(57)【要約】

【目的】 プラスチック基板の両面に樹脂保護層を設け た光ディスクの反りを低減すること。

【構成】 プラスチック基板の一方の面に少なくとも光 記録層が形成され、その上に樹脂保護層が形成されると ともに、他方の面に第2の樹脂保護層が形成される光デ ィスクにおいて、この第1及び第2の樹脂保護層の厚さ をそれぞれ d 1 及び d 2 とし、第1及び第2の樹脂保護 層に生ずる内部応力 (単位断面積当たりの力) をそれぞ れ σ_1 及び σ_2 として、実質的に $\sigma_1 \times d_1 = \sigma_2 \times d$ 2 の条件が成立するようにしている。これにより、プラ スチック基板の両面の各樹脂保護層に生ずる内部応力が 実質的に等しくなってバランスするので、光ディスクの 反りの発生が極力防止される。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 プラスチック基板の一方の面に少なくと も光記録層が形成され、その上に樹脂保護層が形成され るとともに、他方の面に第2の樹脂保護層が形成される 光ディスクにおいて、前記第1及び第2の樹脂保護層の 厚さをそれぞれは1及びは2とし、第1及び第2の樹脂 保護層に生ずる内部広力をそれぞれ。及びσ2とした 場合に、実質的に下記の(1)式が成立するようにした ことを特徴とする光ディスク。

1

$$\sigma_1 \times d_1 = \sigma_2 \times d_2 \tag{1}$$

【請求項2】 前記第1及び第2の樹脂保護層に、水との接触角が30°未満の無機質粒子を分散させたことを特徴とする請求項1に記載の光ディスク。

【発明の詳細な説明】

【0001】 【産業上の利用分野】本発明は、ブラスチック基板に光 記録層を形成した光ディスクに関する。

[0002]

【従来の技術】現在、CD-ROMのような配録情報の 読み取り専用(リード・オンリー)型、情報を一度だけ 20 書き込めるライト・ワンス型、情報の再音き込みが可能 なリライタブル型等の光ディスクが開発され実用化され 始めている。

[0003] このような光ディスクの基板材料としてガラスまたはプラステックが一般的に使用されているが、プラステックは加工や複数が容易であり、材料コストの面でも有利である等の理由でガラス基板とりも好適に使用されている。このプラステック基板の一方の面には少なくとも光記録層が形成され、この光記録層を外的な係、水分による震食等から保護するために、光記録層のが紫外線硬化型樹脂や熱壁化型樹脂などによって形成される。また、他方の面には基皮表面への外的な傷や静電気による座域の付着等を防ぐために、一般にハードコート層と称されている環境性を付与した第2の樹脂保護層が成立れる。この第2の樹脂保護層の材料としては第1の樹脂保護層と同様に業外線硬化型樹脂や熱硬化型樹

脂などが用いられる。 【0004】

【発明が解決しようとする疑題】しかしながら、上記の 40 ような段化型期間に勤命後の硬化収縮によって内部応力 が生じ、更に高温高湿の飛娘下に長時間さらされた場合 などの経時変化に伴う体積収縮によっても内部応力が生 ずる。特に、後者の経時変化に伴うな力発生は影響が大 さく、ガラス基板に比べて剛性が小さいプラステック基 板の場合には、同面の樹脂保暖圏の内部応力の差による 反りが顕著に発生しやすいという問題があった。

【0005】なお、例えば特開平2-193341号公報には、 基板の一方の面に形成された誘電体保護層の圧縮応力と その上に形成された紫外線硬化型樹脂からなる樹脂保護 50

層の内部応力とをバランスさせることにより、製造時に おける光ディスクの反りを小さくすることが提案されて いるが、このような提案では基板の両面に形成された樹 間保護層の経時変化によって生ずる反りを低減させるこ とはできない。

【0006】そこで、本発明は上述の問題点に着目し、 プラスチック基板の両面に樹脂保護層を設けた光ディス クの反りを低減することを課題としてなされたものであ る。

10 [0007]

[環題を解決するための手段] 上述の課題を解決するために、本発明では、プラスチック基板の一方の面に少なくとも光記録層が形成され、その上に樹脂保護層が形成されるとともに、他方の面に第2の樹脂保護層が形成される光ディスクにおいて、この第1及び第2の樹脂保護層に生ずる内部応力、単位断面積当たりの力)をそれぞれの1及びの2として、実質的にの1×4、1。2×4。2、9、7ラスチック基板の両面のを樹脂保護層に生ずる内が、プラスチック基板の両面のを樹脂保護層に生ずる内が、プラスチック基板の両面のを樹脂保護層に生ずる内

0 り、プラスチック基板の両面の各樹脂保護層に生ずる内部応力が実質的に等しくなってパランスするので、光ディスクの反りの発生が極力防止される。

[8000]

【実施例】以下、本発明に係る実施例を詳細に説明する。 図1において、1はポリカーボネート樹脂の基板、2は光起緑陽、3は第1の樹脂保護層である樹脂保護層、4は第2の樹脂保護層であるハードコート層を示す。

[0009] 光記録暦 2は、マグネトロンスパッタリング装配を用いて非品質イットリウムサイアロンの第1 新 電体暦 (100 na原)、非品質G d ー D y ー F e 系の光鑑 気記録器 (20na厚)、非品質イットリウムサイアロンの 第2 新電体層 (30na厚)、及び全属アルミコウム反射層 (100 nam) を頻次積層したものである。

[0010]また、樹脂保護層3とハードコート層4と は以下に示す各種樹脂は料、すなわち樹脂A、B、C、 D、E、Fについて後述する試験を行い、これら樹脂の うち最適なものを塗布して形成した。

[0011] ここで、樹脂Aとしてはアクリル酸エステル系の素外線硬化型樹脂(大日本インキ(株)製 SDー17)を、また樹脂Bとしては、ウレタンアクリレート系の素外線硬化型樹脂(大日本インキ(株)製 SDー301)をそれた使用し、樹脂AにSb-Snの2(粒径移6)に5με, 木に対する接触角の=約5°)のフィラーを混入させたものを樹脂にとした。また、アクリル系例筋が長い底5102(粒径5・8μμ, θ=0~10°)のフィラーを混入させたものを樹脂Dとし、樹脂AにAl」の。(粒径5~8μμ, θ=0~30°)のフィラーを混入させたものを樹脂Dとし、樹脂Aにオリエチレンのとは20。(粒径5~8μμ, θ=20~30°)のフィラーを入るさせたものを樹脂とし、樹脂Aにボリエチレンのと

(粒径4 \sim 6 μ m, θ =約88°) のフィラーを分散させた ものを樹脂Fとした。

【0012】上記各樹脂の経時変化後の内部応力を調べ るために、事前に次のような試験を行った。すなわち、 75μm の薄い板ガラス基板に各樹脂を塗布成膜した後、 80℃、90% RHの高温高湿試験を1000時間実施し、その 前後における基板の反りを測定して内部応力を算出し、 また鉛筆硬度についても測定を行った。その結果は表1 に示すように、樹脂Aの場合は1 ×10⁻⁷dyn/cm²、樹脂 Bは3 ×10-*dyn/cm 2、樹脂Cは8 ×10-*dyn/cm 2、樹 脂Dは4 ×10-8dyn/cm 2、樹脂Eは5 ×10-8dyn/cm 2、 樹脂Fは6 ×10-0dyn/cm 2であった。また、表には示し ていないが、フィラーを樹脂に混入させた試料(樹脂 C, D, E, F) の場合、反り角を示すチルト角は試験 開始後約250 時間程度で飽和し、以後ほとんど変化しな いことが判明し、特に、水との接触角が30°未満の材質 のフィラーを樹脂に混入させた試料(樹脂C, D, E) は、鉛筆硬度がフィラーが無い試料と同様であって、硬 度の低下が全くみられなかった。一方、水との接触角が 30°より大の材質のフィラーを樹脂に混入させた試料の 20 場合は硬度が著しく低下し耐傷性が不十分であった。こ れは、主剤となる樹脂との密着性が弱いために硬度が低 下したものと考えられる。なお、各樹脂層に生ずる実際 の内部応力はこれらの数値と層の断面積とから算出され

る。 【0013】 【表1】

> 有郵金條 樹脂 内部応力 (dyn/cm²) 1 ×10-7 2 H Α 3 ×10-8 2 H В : C 8 ×10⁻⁸ 2 H 4 ×10-a D 2 H Е 5 ×10-8 2 H F 6 ×10-8 HB

【0014】実施例1~5及び比較例は、それぞれ表2 に示すように、樹脂保護層3とハードコート層4の樹脂 の種類と塗布厚さを選定してある。ここで、実施例1は 同一樹脂を同一厚さで塗布しており、実施例2~5は樹 脂の硬化収縮と体積収縮の変化量を考慮して樹脂保護層 3とハードコート層4の内部応力と層の厚さとの積が実 質的に等しくなるようにしている。ここで、実質的に等 しいとは、樹脂保護層3及びハードコート層4の厚さ (μm) をそれぞれ d 1 及び d 2 と し、それぞれの層に 10 生ずる内部応力 (単位面積当たりの力; dyn/cm²) をそ れぞれ σ_1 及び σ_2 とした場合に、 $\sigma_1 \times d_1 と \sigma_2 \times$ d₂との差が±10⁻⁷dyn/cn以内の程度のことをいう。ま た、比較例はこの条件が成立しないようにそれぞれの樹 脂の種類と塗布厚さを選定してある。なお、内部応力の 正の値は引張り応力を示し、負の値は圧縮応力を示す。 また、実施例5は樹脂Βを約5 μω とし、この上に樹脂 Dを約6 μm 塗布したものである。

> 【0015】 【表2】

30

40

	樹脂色	呆護層	ハードコート層		光ディスクの反り (mrad)			
	樹脂	(µm)	樹脂	厚さ (μm)	初期	1000時間後		
実施例 1	В	10	В	10	0. 8	0, 8		
実施例 2	В	12	С	4	1. 1	1.1		
実施例 3	D	7	С	4	1. 4	1.7		
実施例 4	E	7	С	4	1.3	1.5		
実施例 5	B+D	11	С	4	1.0	1.2		
比較例	В	10	A	5	1, 5	3, 8		

【0016】このようにして形成した実施例1~5及び 比較例に対して、上述した80℃,90% R H の条件下での 高温高湿環境試験を1000時間実施し、その前後での反り 30 の変化を機械特性装置によりチルト角を測定して調べ た。表2に示すように、実施例1~5では初期の反りが 小さく、しかも環境試験後の反りに変化が極めて小さい のに対して、比較例では初期の反りは小さいが、環境試 験後では実施例1の4倍以上も増大した反りとなったう え剥離も生じていた。すなわち、樹脂保護層の形成時の 硬化収縮だけでなく、経時変化による体積収縮の変化量 を実質的に等しくすることにより、製造初期と経時変化 後の反りを小さい値に保持することができるのである。 【0017】なお、光ディスクを構成する基板や各層に 40 れらを組合せた材料が使用可能である。 は上記以外の種々の材料が使用可能である。すなわち、 基板としてはエポキシ樹脂、アクリル樹脂、ポリエステ ル樹脂、非晶質ポリオレフィン樹脂等の各種樹脂が使用 可能である。

【0018】また、樹脂保護層とハードコート層として は、アクリル酸エステル系、ウレタンアクリレート系、 エポキシ系、ポリエステル系、アクリル系などの各種素 外線硬化型樹脂あるいは熱硬化型樹脂が使用可能であ り、これら樹脂に混入させるフィラーとしては水との接 触角が30°以下の材質であればよく、例えばITO、S 50 用可能である。

b-SnO2, P-SnO2, Sb2O3, IrO2, MoO2, NbO2, PtO2, RuO2, WO2, M oC, NbC, TaC, TiC, WC, NbN, Ta2 N、TiN、ZrN、VNなどの導電性のセラミックや SiO2 , Al2 O3 , Si3 N4 , SiC, CdS, ZnS、SiOなどの絶縁性セラミック、Ag、Ni、 Au、Tiなどの金属・合金などが単一あるいは2種以 Fの混合物として使用可能である。

【0019】また、第1及び第2誘電体層には、他に窒 化シリコン、窒化アルミニウム、窒化チタン、炭化シリ コン、硫化カドミウム、硫化亜鉛、フッ化マグネシウ ム、酸化カドミウム、酸化ビスマス等が単独あるいはこ

【0020】さらに、光磁気記録層には他にGd-Tb -Fe, Tb-Fe-Co, Dy-Fe-Co, Gd-T b - D y - F e, G d - T b - F e - C o, T b - Dy-Fe-Co, Gd-Dy-Fe-Co, Nd-Gd-Dy-Fe, Nd-Gd-Dy-Fe, Nd-Gd-DyーFe-Co系等の遷移金属-希土類金属系の各種 非晶質磁性合金が使用可能である。

【0021】また、反射層には他にCr、Ti、Cu、 Ag、Au、SUS等が単独あるいは組合せた材料が使 【0022】なおまた、上途の実施例では光磁気配録層 を有したいわゆる光磁気ディスクの場合について示した が、本発明は、光磁気配録層が無く反射層などから成る 光配録層を有したいわゆるCDーROMのような光ディ スクでも適用可能であることはもちろんである。

[0023]

【発明の効果】上述の実施例から明らかなように、本発 明は、プラスチック基板の両面にそれぞれ形成される第 1及び第2の樹脂保護層の内部応力と層の厚さの積が実 質的に等しくなるようにしたものである。

【0024】したがって、蒸板の両面に発生する内部応 力をバランスさせて反りの発生を防止することができる ので、反りが生じやすいというプラスチックの問題点を 解決して、他の多くの利点をいかんなく発揮させること が容易となり、怖に大径の光ディスクにとっては極めて 有利となる。また、貼り合わせの光ディスクでは貼り合 わせ部での剥離をなくすことも可能となる。

【0025】さらに、上配樹脂保護層に水との接触角が 30°未満の無機質粒子を分散させることによって、高温 高温の過酷な環境下においても硬度の低下を極力防止す ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る一実施例の光ディスクの構造を示す断面図である。

10 【符号の説明】

•	符号	70,	iR.	91)					
1				基板	2	٠	٠	٠	光
ic	绿尾	ğ							
3				第1の樹脂保護層	5	٠	٠	٠	第
2	の構	挑	保	護層					

(EX 1)

